

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

公告编号：2024-040

江苏艾森半导体材料股份有限公司

关于拟签署《项目投资协议书》暨对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资项目名称：艾森集成电路材料制造基地项目（项目名称暂定）
- 投资金额：预计项目投资总额为不低于人民币 5 亿元（最终投资金额以实际投资为准）
- 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组

相关风险提示：

- 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》等规定，该事项尚需提交董事会、股东大会审议通过后方可实施，协议的生效尚存在不确定性。
- 如国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，本项目的实施可能存在延期、变更、中止或者终止的风险。
- 项目建设用地目前尚未办理土地出让及土地证等手续，可能存在项目用地无法取得等风险。

一、对外投资概述

江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟与昆山市千灯镇人民政府签署《“艾森集成电路材料制造基地”项目投资协议书》（以下简称“投资协议”），拟在江苏省昆山市千灯镇投资建设艾森集成电路材料制造基地项目，项目总规划约 50 亩（具体面积以挂牌红线图为准）。预计项目投资总额为不低于人民币 50,000 万元。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》等规定，该事项尚需提交董事会、股东大会审议通过方可实施。

二、合作方基本情况

名称：昆山市千灯镇人民政府

关联关系说明：公司与昆山市千灯镇人民政府不存在关联关系

三、拟投资标的基本情况

集成电路材料制造基地项目

1、项目实施主体：江苏艾森半导体材料股份有限公司

2、项目投资规模：预计项目投资总额为不低于人民币 50,000 万元，资金来源为公司自有或自筹资金。

四、投资协议主要内容

（一）签署主体

甲方：昆山市千灯镇人民政府

乙方：江苏艾森半导体材料股份有限公司

（二）项目概况

1、项目内容：公司拟在昆山市千灯镇投资获取项目用地（原昆山市千灯镇黄浦江路 1647 号厂区拆迁置换），并建设“艾森集成电路材料制造基地”项目，项目用地用于建设艾森股份集成电路材料制造中心，产品包括半导体用光刻胶、电镀液、光刻胶树脂、高纯试剂等。

2、项目投资金额

项目总投资额不低于人民币 5 亿元，其中固定资产投资不低于人民币 4.5 亿元，流动资金 5,000 万元。

3、项目用地位置、面积

项目地块位于昆山市精细材料产业园。项目总规划约 50 亩（具体面积以挂牌红线图为准）。

4、项目用地出让价格、年限：项目用地为国有工业用地，土地使用权出让年限为 30/50 年。挂牌地价参照国土部门相关文件规定，通过评估方式确定。

5、土地出让条件

乙方承诺在约定的监管期内达到相应的产值、纳税，双方签署项目 8 年达产监管协议。

6、项目产出效益

项目用地总计约 50 亩。预计达产后总年产值不低于 8 亿元，亩均纳税不低于 70 万/亩。

7、项目监管

开竣工及达产履约保证金为土地出让合同总价款的 40%；开竣工履约保证金为出让金总额的 20%，其中前述开竣工履约保证金的 50%用于开工考核，剩余 50%用于竣工考核；达产履约保证金为出让金总额的 20%，用于达产考核。

8、其他事项

在项目土地挂牌前，完成公司昆山市千灯镇黄浦江路 1647 号厂区的拆迁协议签署。

五、本次对外投资的必要性及对公司的影响

基于整体战略布局及经营发展的需要，为加快产能规划及产业布局，拟投资建设集成电路材料制造基地项目，本项目拟在江苏省昆山市精细材料产业园购置土地建设新的生产基地。该制造基地建成后，将进一步提高公司的产能，以支撑公司光刻胶、电镀液及配套试剂等高端电子化学品未来的产业化需求，从而推动公司业务规模的持续增长，提升公司整体竞争力和盈利能力。

公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，公司目前财务状况良好，预计不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本项目尚处于筹划阶段，考虑到本次投资采取购地新建厂房的方式实施，存在较长的施工建设等准备周期，短期内不会对公司财务状况及业绩带来重大收益。

六、本次投资的主要风险分析

1、项目具体事项待双方签订投资协议，履行公司相关审批决策程序后方可生效和实施。若项目具体事项遇到宏观经济、市场环境、政府政策变化、公司决策审批程序等不可预计或不可抗力因素的影响，可能导致协议部分或全部内容无法履行的风险，因此项目投资事项尚存在不确定性。

2、项目建设用地目前尚未办理土地出让及土地证等手续，可能存在项目用地无法取得等风险。

公司将根据项目进展情况，按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2024年5月21日